

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-89586

(P2013-89586A)

(43) 公開日 平成25年5月13日(2013.5.13)

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
H05B 33/10	(2006.01)	H05B 33/10		3K107
H01L 51/50	(2006.01)	H05B 33/14	A	4K029
C23C 14/04	(2006.01)	C23C 14/04	A	

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 23 頁)

(21) 出願番号	特願2011-232538 (P2011-232538)	(71) 出願人	500171707
(22) 出願日	平成23年10月24日(2011.10.24)		株式会社ブイ・テクノロジー
			神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地
		(74) 代理人	100078330
			弁理士 笹島 富二雄
		(74) 代理人	100087505
			弁理士 西山 春之
		(74) 代理人	100099623
			弁理士 奥山 尚一
		(74) 代理人	100129425
			弁理士 小川 護晃
		(74) 代理人	100154106
			弁理士 荒木 邦夫

最終頁に続く

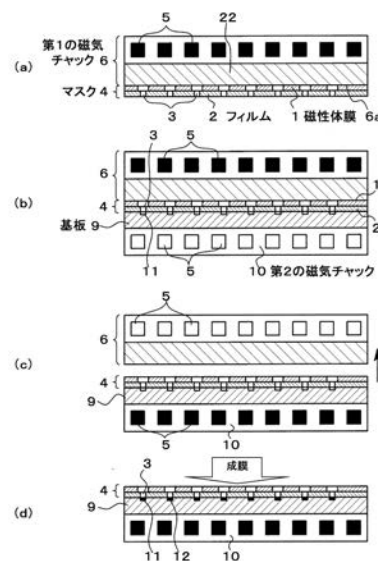
(54) 【発明の名称】 薄膜パターン形成方法及び有機EL表示装置の製造方法並びに有機EL表示装置

(57) 【要約】

【課題】高精細な薄膜パターンの形成を容易に行い得るようにする。

【解決手段】基板9上に一定形状の薄膜パターンを成膜形成する薄膜パターン形成方法であって、可視光を透過し一面に磁性体膜1を被着したフィルム2に薄膜パターン形成領域11に対応して薄膜パターン12と同形状の貫通する開口パターン3を形成し、磁性体膜1側を第1の磁気チャック6の平坦面に吸着して保持されたマスク4の開口パターン3を、第2の磁気チャック10上に載置された基板9の薄膜パターン形成領域11に位置合わせするステップと、第2の磁気チャックにより磁性体膜1を吸着してマスク4を第1の磁気チャック6から基板9上に移すステップと、マスク4の開口パターン3を介して基板9上の薄膜パターン形成領域11に成膜し、薄膜パターン12を形成するステップと、を行うものである。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に一定形状の薄膜パターンを成膜形成する薄膜パターン形成方法であって、
可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに前記薄膜パターンの形成領域に対応して該薄膜パターンと同形状の貫通する開口パターンを形成し、前記磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの前記開口パターンを、磁気チャック上に載置された前記基板の前記薄膜パターン形成領域に位置合わせするステップと、

前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記基板上に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを介して前記基板上の薄膜パターン形成領域に成膜し、薄膜パターンを形成するステップと、
を行うことを特徴とする薄膜パターン形成方法。

【請求項 2】

基板上に一定形状の複数種の薄膜パターンを順次成膜形成する薄膜パターン形成方法であって、

可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに一の薄膜パターンの形成領域に対応して該一の薄膜パターンと同形状の貫通する開口パターンを形成し、前記磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの前記開口パターンを、磁気チャック上に載置された前記基板の前記一の薄膜パターン形成領域に位置合わせするステップと、

前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記基板上に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを介して前記基板上の前記一の薄膜パターン形成領域に成膜し、一の薄膜パターンを形成するステップと、

前記マスクの磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記基板上から前記保持手段に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを前記基板の他の薄膜パターン形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記基板上に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを介して前記他の薄膜パターン形成領域に成膜し、他の薄膜パターンを形成するステップと、
を行うことを特徴とする薄膜パターン形成方法。

【請求項 3】

前記マスクは、

前記フィルムの一面に感光性材料を塗布するステップと、

前記感光性材料を露光現像して前記薄膜パターン形成領域に対応した部分に前記薄膜パターンよりも形状の大きい島パターンを形成するステップと、

前記フィルムの前記島パターンの周辺領域に磁性体膜をメッキ形成するステップと、

前記島パターンを剥離して前記磁性体膜に前記島パターンに対応する開口部を設けてマスク用部材を形成するステップと、

前記マスク用部材を保持手段の平坦面に前記磁性体膜側から吸着して保持するステップと、

磁気チャック上に吸着保持された前記基板の前記薄膜パターン形成領域が前記開口部内に位置するように前記基板と前記マスク用部材とを位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスク用部材を前記保持手段から前記基板上に移すステップと、

前記開口部内の前記薄膜パターン形成領域に対応した前記フィルムの部分に前記開口パターンを形成するステップと、

を行って作製されることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の薄膜パターン形成方法。

【請求項 4】

前記マスクは、前記開口パターンを形成するステップの後、前記磁性体膜側を前記保持

10

20

30

40

50

手段の平坦面に吸着して保持されることを特徴とする請求項 3 記載の薄膜パターン形成方法。

【請求項 5】

前記フィルムの一面に感光性材料を塗布する前に、前記フィルムの一面に金属膜を被着させ、前記開口部を形成した後に、該開口部内の前記金属膜をエッチングして除去することを特徴とする請求項 3 又は 4 記載の薄膜パターン形成方法。

【請求項 6】

有機 E L 表示用 T F T 基板上に一定形状の 3 色対応有機 E L 層を順次形成して有機 E L 表示装置を製造する方法であって、

可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに第 1 の有機 E L 層の形成領域に対応して該第 1 の有機 E L 層と同形状の貫通する開口パターンを形成し、前記磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの前記開口パターンを、磁気チャック上に載置された前記 T F T 基板の前記第 1 の有機 E L 層形成領域に位置合わせするステップと

10

、
前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記 T F T 基板上に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを介して前記 T F T 基板の前記第 1 の有機 E L 層形成領域に第 1 の有機 E L 層を真空蒸着するステップと、

前記マスクの磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記 T F T 基板上から前記保持手段に移すステップと、

20

前記マスクの開口パターンを前記 T F T 基板の第 2 の有機 E L 層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記 T F T 基板上に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを介して前記第 2 の有機 E L 層形成領域に第 2 の有機 E L 層を真空蒸着するステップと、

前記マスクの磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記 T F T 基板上から前記保持手段に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを前記 T F T 基板の第 3 の有機 E L 層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記 T F T 基板上に移すステップと、

30

前記マスクの開口パターンを介して前記第 3 の有機 E L 層形成領域に第 3 の有機 E L 層を真空蒸着するステップと、

を含む工程を実行することを特徴とする有機 E L 表示装置の製造方法。

【請求項 7】

T F T 基板上に一定形状の 3 色対応の有機 E L 層を順次成膜形成して製造される有機 E L 表示装置であって、

可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに第 1 の有機 E L 層の形成領域に対応して該第 1 の有機 E L 層と同形状の貫通する開口パターンを形成し、前記磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの前記開口パターンを、磁気チャック上に載置された前記 T F T 基板の前記第 1 の有機 E L 層形成領域に位置合わせするステップと

40

、
前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記 T F T 基板上に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを介して前記 T F T 基板の前記第 1 の有機 E L 層形成領域に第 1 の有機 E L 層を真空蒸着するステップと、

前記マスクの磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記 T F T 基板上から前記保持手段に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを前記 T F T 基板の第 2 の有機 E L 層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記 T F T 基板上に移すステップと、

50

前記マスクの開口パターンを介して前記第２の有機ＥＬ層形成領域に第２の有機ＥＬ層を真空蒸着するステップと、

前記マスクの磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記ＴＦＴ基板上から前記保持手段に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを前記ＴＦＴ基板の第３の有機ＥＬ層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記ＴＦＴ基板上に移すステップと、

前記マスクの開口パターンを介して前記第３の有機ＥＬ層形成領域に第３の有機ＥＬ層を真空蒸着するステップと、

を含む工程を実行して製造されることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

本発明は、基板上に一定形状の薄膜パターンを成膜形成する薄膜パターン形成方法に関し、特に高精細な薄膜パターンの形成を容易に行い得るようにする薄膜パターン形成方法及び有機ＥＬ表示装置の製造方法並びに有機ＥＬ表示装置に係るものである。

【背景技術】

【０００２】

従来、この種の薄膜パターン形成方法は、所定の成膜パターンに対応した複数の開口が設けられた強磁性体から成るメタルマスクを基板の一面を覆うように基板に密着させると共に、基板の他面側に配置された磁石の磁力を利用して固定され、真空蒸着装置の真空槽内で上記開口を通して基板の一面に蒸着材料を付着させ、薄膜パターンを形成するようになっていた（例えば、特許文献１参照）。

20

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００３】

【特許文献１】特開２００９－１６４０２０号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【０００４】

30

しかし、このような従来 of 薄膜パターン形成方法において、一般に、数十 μm ～数 mm の厚みの金属板に薄膜パターンに対応した開口を例えばエッチング等により形成してマスクが作られるので、金属板の厚みが厚い場合には開口を高精度に形成することが困難であり、又金属板の熱膨張による位置ずれや反り等の影響で例えば３００ dpi 以上の高精細な薄膜パターンの形成が困難であった。

【０００５】

また、マスク用金属板の厚みを３０ μm 程度まで薄くした場合には、３００ dpi に相当する開口を形成することは可能となるものの、開口を形成した部分の金属板が極めて薄いためよじれやたわみが生じ、開口の形状及び位置を精度よく保持することが困難である。したがって、基板上の薄膜パターン形成領域にマスクの開口を精度よく位置合わせすることができず、それ故、ただ単に、マスク用金属板の厚みを薄くしただけでは、３００ dpi 以上の高精細な薄膜パターンを形成することは困難である。

40

【０００６】

そこで、本発明は、このような問題点に対処し、高精細な薄膜パターンの形成を容易に行い得るようにする薄膜パターン形成方法及び有機ＥＬ表示装置の製造方法並びに有機ＥＬ表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【０００７】

上記目的を達成するために、第１の発明による薄膜パターン形成方法は、基板上に一定形状の薄膜パターンを成膜形成する薄膜パターン形成方法であって、可視光を透過し一面

50

に磁性体膜を被着したフィルムに前記薄膜パターンの形成領域に対応して該薄膜パターンと同形状の貫通する開口パターンを形成し、前記磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの前記開口パターンを、磁気チャック上に載置された前記基板の前記薄膜パターン形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記基板上に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記基板上の薄膜パターン形成領域に成膜し、薄膜パターンを形成するステップと、を行うものである。

【0008】

このような構成により、可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに薄膜パターンの形成領域に対応して該薄膜パターンと同形状の貫通する開口パターンを形成し、磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの開口パターンを、磁気チャック上に載置された基板の薄膜パターン形成領域に位置合わせした後、磁気チャックにより上記磁性体膜を吸着してマスクを保持手段から基板上に移し、マスクの開口パターンを介して基板上の薄膜パターン形成領域に成膜し、薄膜パターンを形成する。

【0009】

また、第2の発明による薄膜パターン形成方法は、基板上に一定形状の複数種の薄膜パターンを順次成膜形成する薄膜パターン形成方法であって、可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに一の薄膜パターンの形成領域に対応して該一の薄膜パターンと同形状の貫通する開口パターンを形成し、前記磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの開口パターンを、磁気チャック上に載置された前記基板の前記一の薄膜パターン形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記基板上に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記基板上の前記一の薄膜パターン形成領域に成膜し、一の薄膜パターンを形成するステップと、前記マスクの磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記基板上から前記保持手段に移すステップと、前記マスクの開口パターンを前記基板の他の薄膜パターン形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記基板上に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記他の薄膜パターン形成領域に成膜し、他の薄膜パターンを形成するステップと、を行うものである。

【0010】

このような構成により、可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに一の薄膜パターンの形成領域に対応して該一の薄膜パターンと同形状の貫通する開口パターンを形成し、磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの開口パターンを、磁気チャック上に載置された基板の上記一の薄膜パターン形成領域に位置合わせした後、磁気チャックにより磁性体膜を吸着してマスクを保持手段から基板上に移し、マスクの開口パターンを介して基板上の上記一の薄膜パターン形成領域に成膜し、一の薄膜パターンを形成し、マスクの磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して、マスクを基板上から保持手段に移し、マスクの開口パターンを基板の他の薄膜パターン形成領域に位置合わせした後、磁気チャックにより磁性体膜を吸着してマスクを保持手段から基板上に移し、マスクの開口パターンを介して上記他の薄膜パターン形成領域に成膜し、他の薄膜パターンを形成する。

【0011】

好ましくは、前記マスクは、前記フィルムの一面に感光性材料を塗布するステップと、前記感光性材料を露光現像して前記薄膜パターン形成領域に対応した部分に前記薄膜パターンよりも形状の大きい島パターンを形成するステップと、前記フィルムの前記島パターンの周辺領域に磁性体膜をメッキ形成するステップと、前記島パターンを剥離して前記磁性体膜に前記島パターンに対応する開口部を設けてマスク用部材を形成するステップと、前記マスク用部材を保持手段の平坦面に前記磁性体膜側から吸着して保持するステップと、磁気チャック上に吸着保持された前記基板の前記薄膜パターン形成領域が前記開口部内に位置するように前記基板と前記マスク用部材とを位置合わせした後、前記磁気チャック

10

20

30

40

50

により前記磁性体膜を吸着して前記マスク用部材を前記保持手段から前記基板上に移すステップと、前記開口部内の前記薄膜パターン形成領域に対応した前記フィルムの部分に前記開口パターンを形成するステップと、を行って作製されるのが望ましい。

【0012】

この場合、前記マスクは、前記開口パターンを形成するステップの後、前記磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して保持されるとよい。

さらに好ましくは、前記フィルムの一面に感光性材料を塗布する前に、前記フィルムの一面に金属膜を被着させ、前記開口部を形成した後に、該開口部内の前記金属膜をエッチングして除去するのが望ましい。

【0013】

10

また、本発明による有機EL表示装置の製造方法は、有機EL表示用TF基板に一定形状の3色対応有機EL層を順次形成して有機EL表示装置を製造する方法であって、可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに第1の有機EL層の形成領域に対応して該第1の有機EL層と同形状の貫通する開口パターンを形成し、前記磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの開口パターンを、磁気チャック上に載置された前記TF基板の前記第1の有機EL層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記TF基板に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記TF基板の前記第1の有機EL層形成領域に第1の有機EL層を真空蒸着するステップと、前記マスクの磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記TF基板上から前記保持手段に移すステップと、前記マスクの開口パターンを前記TF基板の第2の有機EL層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記TF基板に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記第2の有機EL層形成領域に第2の有機EL層を真空蒸着するステップと、前記マスクの磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記TF基板上から前記保持手段に移すステップと、前記マスクの開口パターンを前記TF基板の第3の有機EL層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記TF基板に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記第3の有機EL層形成領域に第3の有機EL層を真空蒸着するステップと、を含む工程を実行するものである。

20

30

【0014】

さらに、本発明の有機EL表示装置は、TF基板に一定形状の3色対応の有機EL層を順次成膜形成して製造される有機EL表示装置であって、可視光を透過し一面に磁性体膜を被着したフィルムに第1の有機EL層の形成領域に対応して該第1の有機EL層と同形状の貫通する開口パターンを形成し前記磁性体膜側を保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクの開口パターンを、磁気チャック上に載置された前記TF基板の前記第1の有機EL層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記TF基板に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記TF基板の前記第1の有機EL層形成領域に第1の有機EL層を真空蒸着するステップと、前記マスクの磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記TF基板上から前記保持手段に移すステップと、前記マスクの開口パターンを前記TF基板の第2の有機EL層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記TF基板に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記第2の有機EL層形成領域に第2の有機EL層を真空蒸着するステップと、前記マスクの磁性体膜側を前記保持手段の平坦面に吸着して、前記マスクを前記TF基板上から前記保持手段に移すステップと、前記マスクの開口パターンを前記TF基板の第3の有機EL層形成領域に位置合わせした後、前記磁気チャックにより前記磁性体膜を吸着して前記マスクを前記保持手段から前記TF基板に移すステップと、前記マスクの開口パターンを介して前記第3の有機EL層形成領域に第3の有機EL層を真空蒸着するステップと、を含む工程を実行して製造

40

50

されるものである。

【発明の効果】

【0015】

本発明によれば、基板上の薄膜パターン形成領域に対応して開口パターンを形成したフィルム的一面に磁性体膜を設けて構成されたマスクの磁性体膜側を平坦面を有する保持手段に吸着して保持しているため、厚みが30 μ m程度の薄いフィルムに高精細な開口パターンが形成されていても、マスクによじれやたわみが生じることがなく、開口パターンの形状及び位置を精度よく保持することができる。

【0016】

また、薄膜パターン形成時には、保持手段に保持されたマスクを磁気チャック上に載置された基板に対して位置合わせした後、磁気チャックによりマスクの磁性体膜を吸着してマスクを保持手段から基板上に移すようにしているため、マスクの開口パターンの形状及び位置をそのまま維持することができる。したがって、マスクの開口パターンを基板の薄膜パターン形成領域上に位置精度よく合致させることができ、高精細な薄膜パターンの形成を容易に行なうことができる。これにより、300dpi以上の高精細な有機EL表示装置の製造も可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明による薄膜パターン形成方法の実施形態を示す工程図である。

【図2】本発明による薄膜パターン形成方法に使用するマスクの一構成例を示す図であり、(a)は平面図、(b)は(a)のO-O線断面矢視図である。

【図3】上記マスクの作製工程の前半工程を示す断面図である。

【図4】上記マスクの作製工程の途中工程を示す断面図である。

【図5】上記マスクの作製工程の後半工程を示す断面図である。

【図6】本発明による有機EL表示装置の製造方法を説明する図であり、赤色有機EL層の形成工程の前半工程を示す断面図である。

【図7】赤色有機EL層の形成工程の後半工程を示す断面図である。

【図8】本発明による有機EL表示装置の製造方法を説明する図であり、緑色有機EL層の形成工程の前半工程を示す断面図である。

【図9】緑色有機EL層の形成工程の後半工程を示す断面図である。

【図10】本発明による有機EL表示装置の製造方法を説明する図であり、青色有機EL層の形成工程の前半工程を示す断面図である。

【図11】青色有機EL層の形成工程の後半工程を示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明による薄膜パターン形成方法の実施形態を示す工程図である。この薄膜パターン形成方法は、基板上に一定形状の薄膜パターンを成膜形成するものであり、保持手段の平坦面に吸着して保持されたマスクを基板に対して位置合わせする第1ステップと、マスクを保持手段から基板上に移す第2ステップと、薄膜パターンを形成する第3ステップとを含んで構成されている。

【0019】

まず、第1ステップにおいては、図1(a)に示すように、可視光を透過し一面に磁性体膜1を被着した例えばポリイミドやポリエチレンテレフタレート(PET)等の樹脂製のフィルム2に薄膜パターンの形成領域に対応して該薄膜パターンと同形状の貫通する開口パターン3を形成し、上記磁性体膜1側を保持手段としての例えば電磁石5を備えて構成された第1の磁気チャック6の平坦面に形成された吸着面6aに、電磁石5により磁性体膜1を吸着して保持されたマスク4(図2参照)の開口パターン3を、同図(b)に示すように、第2の磁気チャック10上に載置された基板9の薄膜パターン形成領域11に位置合わせする。この場合、マスク4の開口パターン3と基板9の薄膜パターン形成領域1

1との位置合わせは、マスク4に予め形成したマスク側アライメントマーク8と基板9に予め形成した図示省略の基板側アライメントマークとを顕微鏡により観察しながら、両マークが一定の位置関係となるように調整して行われる。なお、第1の磁気チャック6の吸着面6aは、ガラスや緻密なセラミック等の硬質材料により平坦に形成されるとよい。これにより、吸着面6aを滑らかに形成することができ、マスク4を吸着面6a全面で均一に吸着して保持することができる。この場合、上記硬質材料(例えばガラス22)の厚みは、基板9上に載置されたマスク4の磁性体膜1に作用する第1及び第2の磁気チャック6, 10の磁力の大きさが略等しくなるように決められるのが望ましい。

【0020】

ここで、保持手段は、一定電圧を印加可能に構成され、フィルム2を静電吸着する静電チャックでもよいが、以下の説明においては、保持手段が磁気チャックの場合について述べる。なお、図2において、符号7は磁性体膜1に設けられた開口部7を示す。また、以下の説明において、磁気チャックの図中黒く塗りつぶした電磁石5は「オン状態」を示し、白抜きの電磁石5は「オフ状態」を示す。

【0021】

次に、第2ステップにおいては、図1(c)に示すように第2の磁気チャック10の電磁石5をオンすると共に第1の磁気チャック6の電磁石5をオフし、第2の磁気チャック10により磁性体膜1を吸着してマスク4を第1の磁気チャック6から基板9上に移す。

【0022】

次いで、第3ステップにおいては、図1(d)に示すように、基板9をマスク4と一体的に第2の磁気チャック10に保持した状態で例えば真空蒸着装置の真空槽内に設置し、蒸着材料をマスク4の開口パターン3を介して基板9に被着させ、基板9上の薄膜パターン形成領域11に薄膜パターン12を形成する。

【0023】

ここで、上記マスク4は次のようにして作製することができる。以下、図3～図5を参照してマスク4の作製方法を説明する。

まず、図3(a)に示すように、平坦面を有する図示省略のステージ上に例えば静電吸着して保持された可視光を透過する厚みが10 μ m～30 μ m程度の、例えばポリイミドのフィルム2の一面2aに、同図(b)に示すようにスパッタリング等の公知の成膜技術により50nm程度の厚みの例えばニッケル(Ni)等からなる磁性体膜の下地層13を被着する。この場合、下地層13は、磁性体膜に限られず、良電導体の非磁性金属膜であってもよい。

【0024】

次に、図3(c)に示すように、下地層13上に30 μ m程度の厚みのレジスト14(感光性材料)を例えばスピコートする。

【0025】

次いで、図3(d)に示すように、フォトマスク15を使用して露光し、同図(e)に示すように現像して、基板9上の薄膜パターン形成領域11に対応した部分に薄膜パターン12よりも形状の大きいレジスト14の島パターン16を形成する。この場合、レジスト14がネガ型であるときには、使用するフォトマスク15は、基板9上の薄膜パターン形成領域11に対応した部分に開口を形成したものであり、レジスト14がポジ型であるときには、フォトマスク15は、基板9上の薄膜パターン形成領域11に対応した部分を遮光するものである。

【0026】

続いて、図3(f)に示すように、フィルム2の上記島パターン16の周辺領域にニッケル(Ni)等の磁性体膜1を30 μ m程度の厚みにメッキ形成する。

【0027】

さらに、図3(g)に示すように、上記島パターン16を剥離して磁性体膜1に島パターン16に対応する開口部7を形成した後、同図(h)に示すように、開口部7内の下地層13をエッチングして除去し、マスク用部材17を形成する。なお、マスク用部材17

10

20

30

40

50

の予め定められた位置には、磁性体膜 1 により基板 9 との位置合わせをするためのマスク側アライメントマーク 8 が形成される。

【0028】

このように形成されたマスク用部材 17 は、図 4 (a) に示すように吸着面 6a が平坦面に形成された第 1 の磁気チャック 6 によって磁性体膜 1 側を吸着して保持される。

【0029】

次に、図 4 (b) に示すように、吸着面 10a が平坦面に形成された第 2 の磁気チャック 10 上に載置された基板 9 (例えば有機 EL 表示用 TFT 基板) の上方にマスク用部材 17 を位置付け、基板 9 に予め形成された図示省略の基板側アライメントマークとマスク用部材 17 に予め形成されたマスク側アライメントマーク 8 とを顕微鏡により観察しながら、両マークが一定の位置関係となるように調整して、同図 (c) に示すように薄膜パターン形成領域 11 (例えばアノード電極上の領域) が上記開口部 7 内に位置するように基板 9 とマスク用部材 17 とを位置合わせした後、基板 9 上にフィルム 2 を密着させる。その後、同図 (d) に示すように、第 2 の磁気チャック 10 の電磁石 5 をオンすると共に第 1 の磁気チャック 6 の電磁石 5 をオフし、第 2 の磁気チャック 10 により磁性体膜 1 を吸着してマスク用部材 17 を第 1 の磁気チャック 6 から基板 9 上に移す。

10

【0030】

続いて、波長が 400nm 以下の、例えば KrF 248nm のエキシマレーザを使用し、図 5 (a) に示すように、マスク用部材 17 の開口部 7 内の薄膜パターン形成領域に対応したフィルム 2 の部分にエネルギー密度が $0.1 \text{ J/cm}^2 \sim 20 \text{ J/cm}^2$ のレーザ光 L を照射し、底に薄い層を残して一定深さの凹部 20 を形成する。次いで、同図 (b) に示すように、公知のプラズマ処理装置内でプラズマ処理し、上記凹部 20 の底の薄い層を除去して貫通する開口パターン 3 を形成する。これにより、マスク 4 が作製される。

20

【0031】

次に、上記マスク 4 上に第 1 の磁気チャック 6 が置かれる。そして、図 5 (c) に示すように、第 1 の磁気チャック 6 の電磁石 5 をオンすると共に第 2 の磁気チャック 10 の電磁石 5 をオフし、第 1 の磁気チャック 6 により磁性体膜 1 を吸着してマスク 4 を第 1 の磁気チャック 6 に移す。以後、マスク 4 は第 1 の磁気チャック 6 に保持された状態で保管される。

【0032】

30

なお、続けて、基板 9 上に薄膜パターン 12 (例えば有機 EL 層) を成膜形成する場合には、図 5 (b) においてマスク 4 が形成されると、基板 9 をマスク 4 と一体的に第 2 の磁気チャック 10 に保持した状態で例えば真空蒸着装置の真空槽内に設置し、マスク 4 の開口パターン 3 を介して蒸着材料を真空蒸着し、薄膜パターン 12 を形成してもよい。

【0033】

次に、上記マスク 4 を使用して、TFT 基板 18 上に一定形状の複数種の薄膜パターン 12 としての R (赤色) 有機 EL 層、G (緑色) 有機 EL 層及び B (青色) 有機 EL 層を形成して有機 EL 表示装置を製造する方法について説明する。

最初に、図 6 及び図 7 を参照して TFT 基板 18 上に正孔注入層、正孔輸送層、R 発光層、電子輸送層等の積層構造となるように順次成膜して R 有機 EL 層を形成する場合について説明する。この場合、先ず、図 6 (a) に示すように、第 1 の磁気チャック 6 に吸着して保持されたマスク 4 を第 2 の磁気チャック 10 上に載置された TFT 基板 18 の上方に位置付け、同図 (b) に示すように、マスク側アライメントマーク 8 と R 用基板側アライメントマークとを顕微鏡により観察しながら、両マークが一定の位置関係となるように調整してマスク 4 と TFT 基板 18 とを位置合わせした後、TFT 基板 18 上にフィルム 2 を密着させる。これにより、マスク 4 の開口パターン 3 が TFT 基板 18 の R 対応アノード電極 19R 上に位置付けられることになる。

40

【0034】

その後、図 6 (c) に示すように、第 2 の磁気チャック 10 の電磁石 5 をオンすると共に第 1 の磁気チャック 6 の電磁石 5 をオフし、第 2 の磁気チャック 10 によりマスク 4 の

50

磁性体膜 1 を吸着してマスク 4 を第 1 の磁気チャック 6 から T F T 基板 1 8 上に移す。

【 0 0 3 5 】

次に、図 7 (a) に示すように、T F T 基板 1 8 とマスク 4 とを一体的に第 2 の磁気チャック 1 0 に保持した状態で図示省略の真空蒸着装置の真空槽内に設置し、マスク 4 の開口パターン 3 を介して T F T 基板 1 8 の R 対応アノード電極 1 9 上の R 有機 E L 層形成領域に R 有機 E L 層 2 1 R を真空蒸着する。

【 0 0 3 6 】

次いで、真空槽内から第 2 の磁気チャック 1 0 を取り出し、図 7 (b) に示すように、マスク 4 上に第 1 の磁気チャック 6 を置き、同図 (c) に示すように第 1 の磁気チャック 6 の電磁石 5 をオンすると共に第 2 の磁気チャック 1 0 の電磁石 5 をオフし、マスク 4 の磁性体膜 1 を第 1 の磁気チャック 6 により吸着してマスク 4 を T F T 基板 1 8 側から第 1 の磁気チャック 6 側に移す。これにより、T F T 基板 1 8 の R 対応アノード電極 1 9 R 上に R 有機 E L 層 2 1 R が形成される。

10

【 0 0 3 7 】

次に、図 8 及び図 9 を参照して T F T 基板 1 8 上に G 有機 E L 層を形成する場合について説明する。この場合、先ず、図 8 (a) に示すように、第 1 の磁気チャック 6 に吸着して保持されたマスク 4 を第 2 の磁気チャック 1 0 上に載置された T F T 基板 1 8 の上方に位置付け、同図 (b) に示すように、マスク側アライメントマーク 8 と G 用基板側アライメントマークとを顕微鏡により観察しながら、両マークが一定の位置関係となるように調整してマスク 4 と T F T 基板 1 8 とを位置合わせした後、T F T 基板 1 8 上にフィルム 2 を密着させる。これにより、マスク 4 の開口パターン 3 が T F T 基板 1 8 の G 対応アノード電極 1 9 G 上に位置付けられることになる。

20

【 0 0 3 8 】

その後、図 8 (c) に示すように、第 2 の磁気チャック 1 0 の電磁石 5 をオンすると共に第 1 の磁気チャック 6 の電磁石 5 をオフし、第 2 の磁気チャック 1 0 によりマスク 4 の磁性体膜 1 を吸着してマスク 4 を第 1 の磁気チャック 6 から T F T 基板 1 8 上に移す。

【 0 0 3 9 】

次に、図 9 (a) に示すように、T F T 基板 1 8 とマスク 4 とを一体的に第 2 の磁気チャック 1 0 に保持した状態で真空蒸着装置の真空槽内に設置し、マスク 4 の開口パターン 3 を介して T F T 基板 1 8 の G 対応アノード電極 1 9 G 上の G 有機 E L 層形成領域に G 有機 E L 層 2 1 G を真空蒸着する。

30

【 0 0 4 0 】

次いで、真空槽内から第 2 の磁気チャック 1 0 を取り出し、図 9 (b) に示すようにマスク 4 上に第 1 の磁気チャック 6 を置き、同図 (c) に示すように第 1 の磁気チャック 6 の電磁石 5 をオンすると共に第 2 の磁気チャック 1 0 の電磁石 5 をオフし、マスク 4 の磁性体膜 1 を第 1 の磁気チャック 6 により吸着してマスク 4 を T F T 基板 1 8 側から第 1 の磁気チャック 6 側に移す。これにより、T F T 基板 1 8 の G 対応アノード電極 1 9 G 上に G 有機 E L 層 2 1 G が形成される。

【 0 0 4 1 】

次に、図 1 0 及び図 1 1 を参照して T F T 基板 1 8 上に B 有機 E L 層を形成する場合について説明する。この場合、先ず、図 1 0 (a) に示すように、第 1 の磁気チャック 6 に吸着して保持されたマスク 4 を第 2 の磁気チャック 1 0 上に載置された T F T 基板 1 8 の上方に位置付け、同図 (b) に示すように、マスク側アライメントマーク 8 と B 用基板側アライメントマークとを顕微鏡により観察しながら、両マークが一定の位置関係となるように調整してマスク 4 と T F T 基板 1 8 とを位置合わせした後、T F T 基板 1 8 上にフィルム 2 を密着させる。これにより、マスク 4 の開口パターン 3 が T F T 基板 1 8 の B 対応アノード電極 1 9 B 上に位置付けられることになる。

40

【 0 0 4 2 】

その後、図 1 0 (c) に示すように、第 2 の磁気チャック 1 0 の電磁石 5 をオンすると共に第 1 の磁気チャック 6 の電磁石 5 をオフし、第 2 の磁気チャック 1 0 によりマスク 4

50

の磁性体膜 1 を吸着してマスク 4 を第 1 の磁気チャック 6 から T F T 基板 1 8 上に移す。

【 0 0 4 3 】

次に、図 1 1 (a) に示すように、T F T 基板 1 8 とマスク 4 とを一体的に第 2 の磁気チャック 1 0 に保持した状態で真空蒸着装置の真空槽内に設置し、マスク 4 の開口パターン 3 を介して T F T 基板 1 8 の B 対応アノード電極 1 9 B 上の B 有機 E L 層形成領域に B 有機 E L 層 2 1 B を真空蒸着する。

【 0 0 4 4 】

次いで、真空槽内から第 2 の磁気チャック 1 0 を取り出し、図 1 1 (b) に示すように、マスク 4 上に第 1 の磁気チャック 6 を置き、同図 (c) に示すように第 1 の磁気チャック 6 の電磁石 5 をオンすると共に第 2 の磁気チャック 1 0 の電磁石 5 をオフし、マスク 4 の磁性体膜 1 を第 1 の磁気チャック 6 により吸着してマスク 4 を T F T 基板 1 8 上から第 1 の磁気チャック 6 側に移す。これにより、T F T 基板 1 8 の B 対応アノード電極 1 9 B 上に B 有機 E L 層 2 1 B が形成される。

【 0 0 4 5 】

その後、T F T 基板 1 8 の各有機 E L 層 2 1 上には、公知の技術を使用して I T O (Indium Tin Oxide) の透明導電膜が形成され、さらにその上に透明な保護基板 9 が接着されて有機 E L 表示装置が製造される。

【 0 0 4 6 】

一方、マスク 4 は、上述と同様にして第 1 の磁気チャック 6 側から第 2 の磁気チャック 1 0 側に移され、プラズマ処理装置内でプラズマ処理してマスク 4 上に付着した有機 E L 蒸着材料が除去される。そして、このようにして洗浄されたマスク 4 は、再び第 1 の磁気チャック 6 に移されて第 1 の磁気チャック 6 に保持された状態で、又は第 2 の磁気チャック 1 0 に保持されたままで保管される。したがって、マスク 4 がよじれたり撓んだりして開口パターン 3 の形状が崩れたり位置がずれたりするおそれがない。

【 0 0 4 7 】

なお、上記 R 有機 E L 層 2 1 R、G 有機 E L 層 2 1 G 及び B 有機 E L 層 2 1 B の形成工程は、同一のマスク 4 を使用して一連の工程として実行することができる。

【 符号の説明 】

【 0 0 4 8 】

- 1 ... 磁性体膜
- 2 ... フィルム
- 3 ... 開口パターン
- 4 ... マスク
- 6 ... 第 1 の磁気チャック (保持手段)
- 6 a ... 第 1 の磁気チャックの吸着面
- 7 ... 開口部
- 9 ... 基板
- 1 0 ... 第 2 の磁気チャック (磁気チャック)
- 1 0 a ... 第 2 の磁気チャックの吸着面
- 1 1 ... 薄膜パターン形成領域
- 1 2 ... 薄膜パターン
- 1 3 ... 下地膜 (金属膜)
- 1 4 ... レジスト (感光性材料)
- 1 6 ... 島パターン
- 1 8 ... T F T 基板
- 2 1 R ... R 有機 E L 層
- 2 1 G ... G 有機 E L 層
- 2 1 B ... B 有機 E L 層

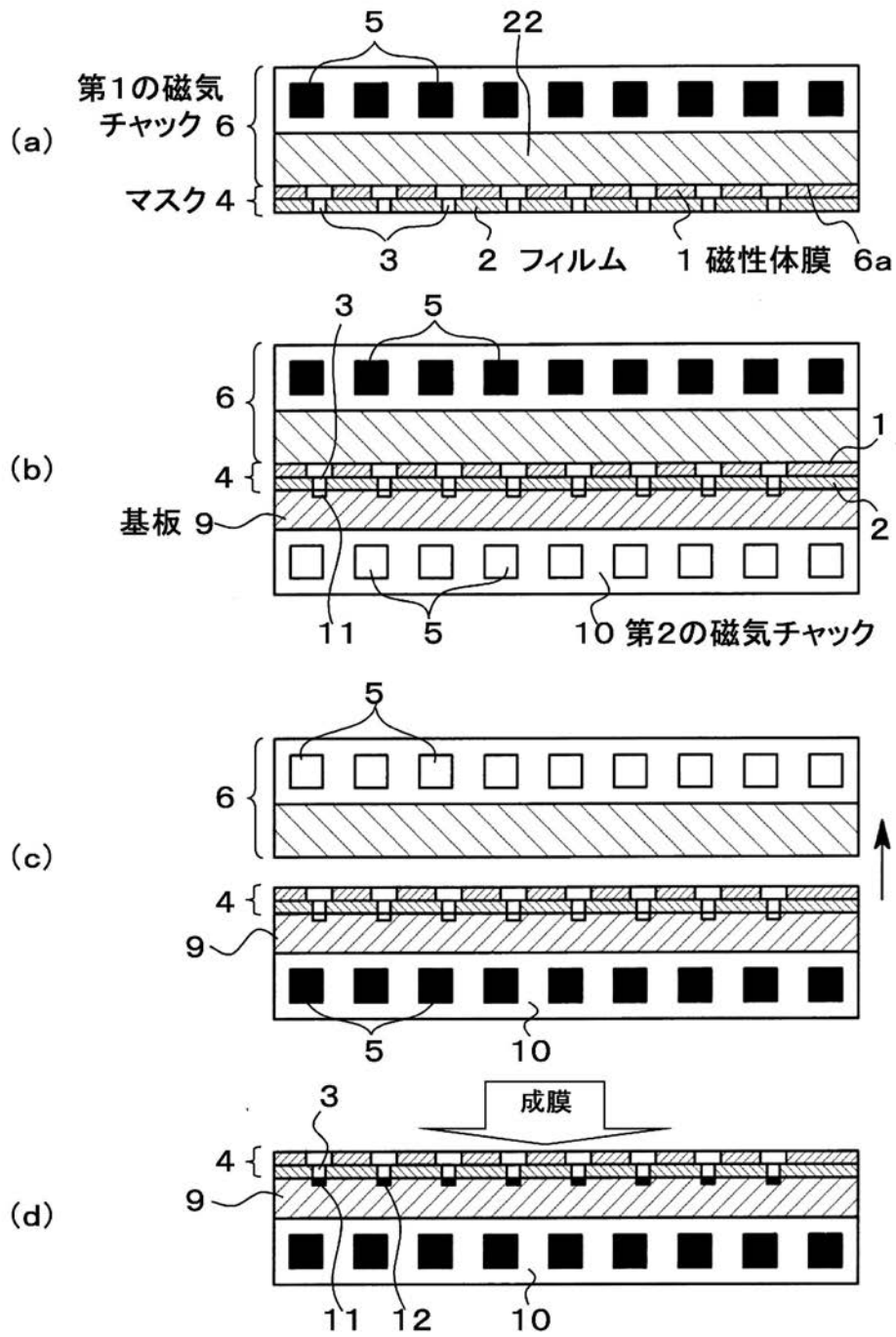
10

20

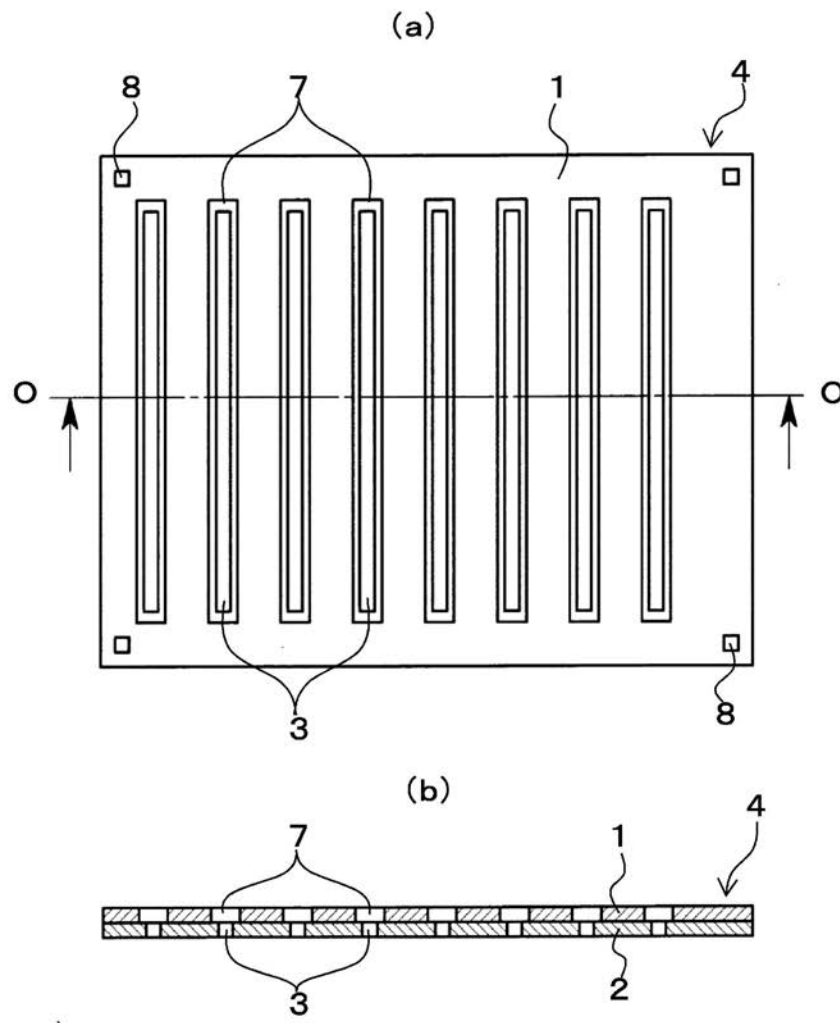
30

40

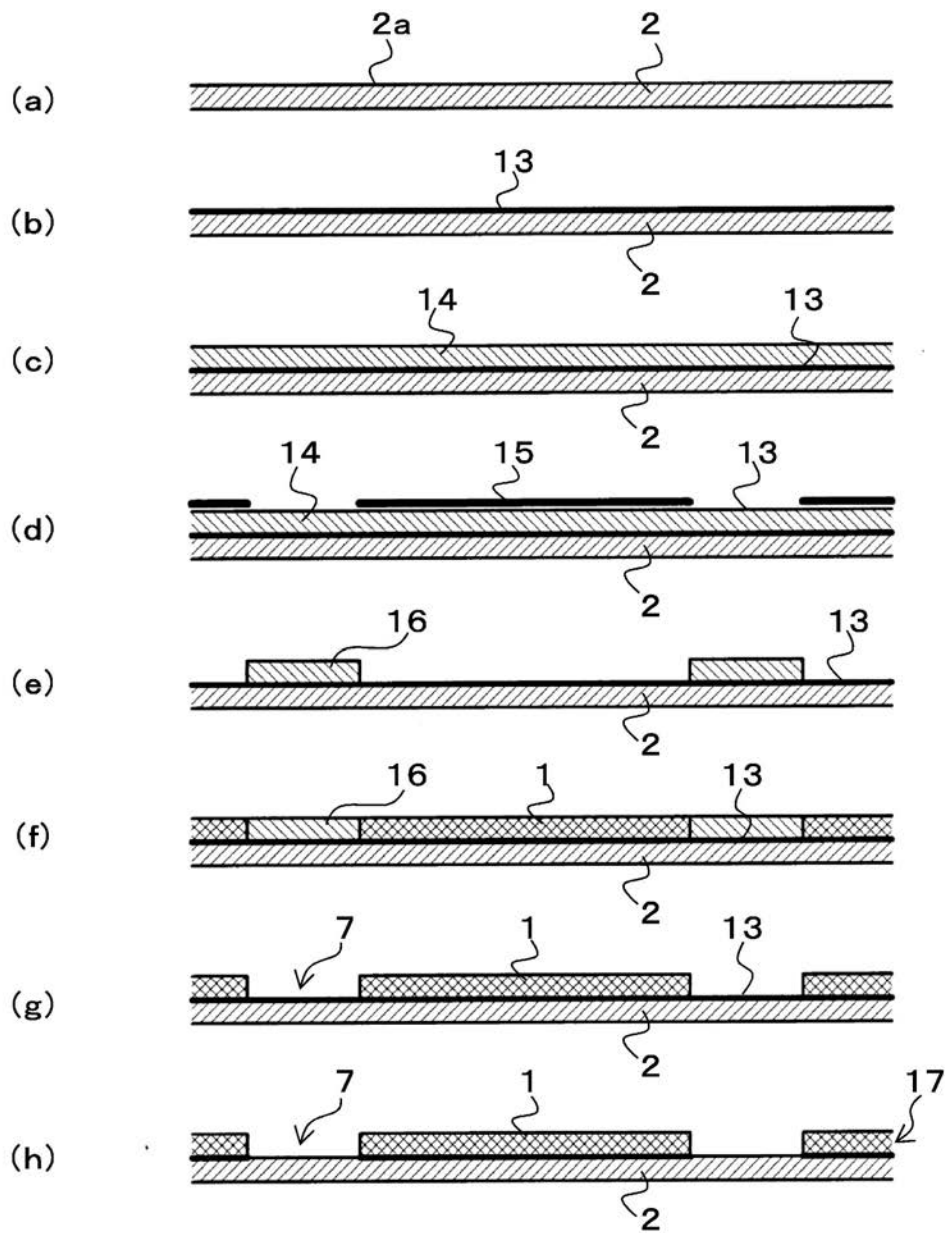
【 図 1 】



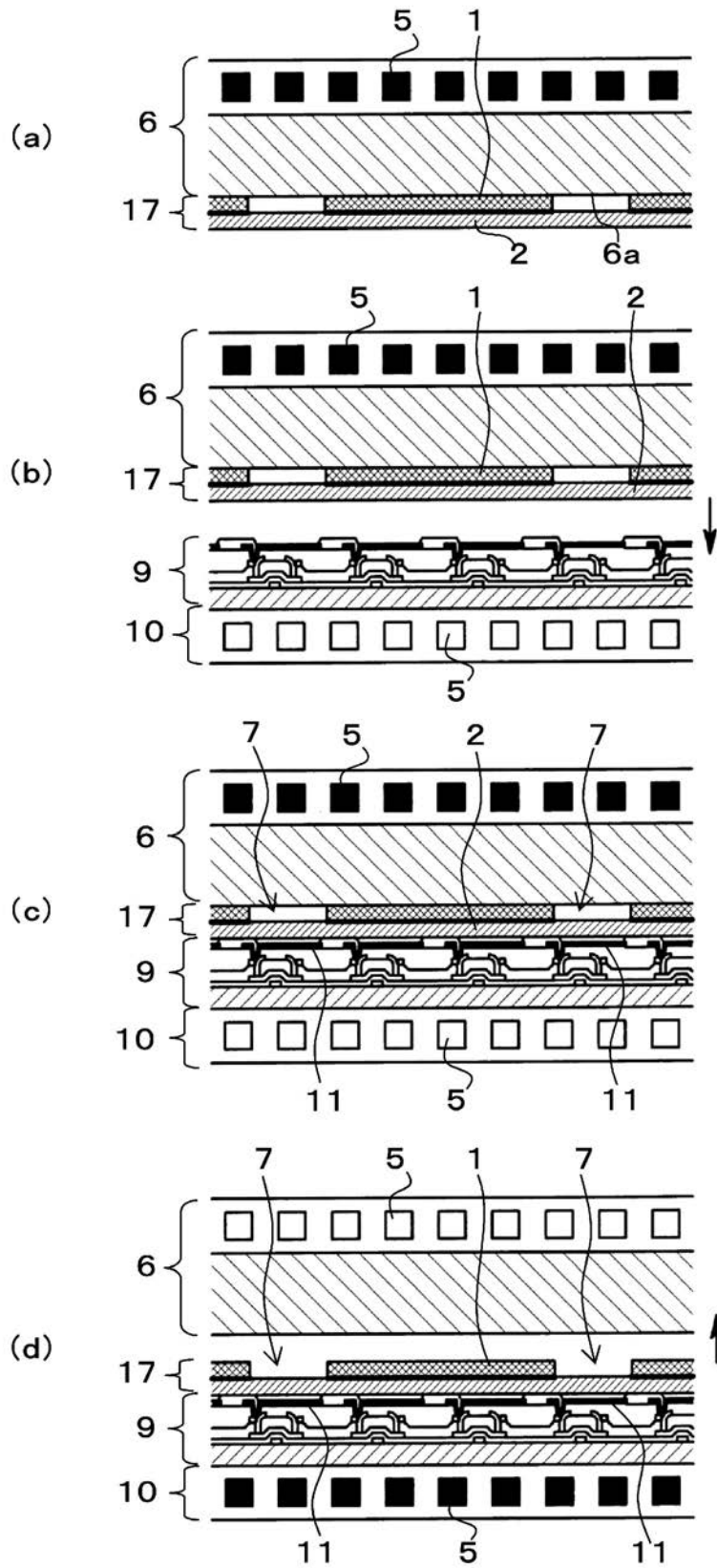
【図 2】



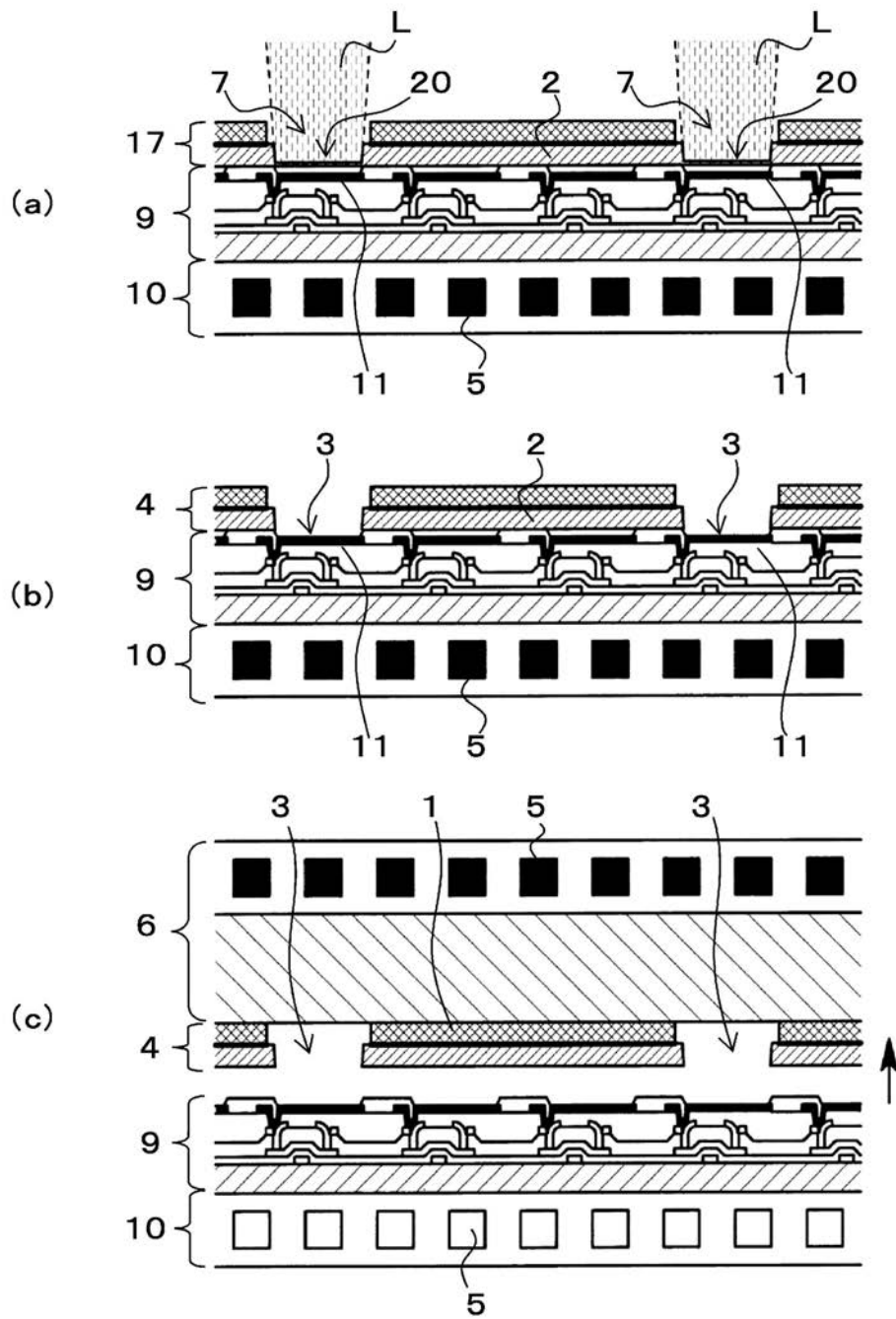
【 図 3 】



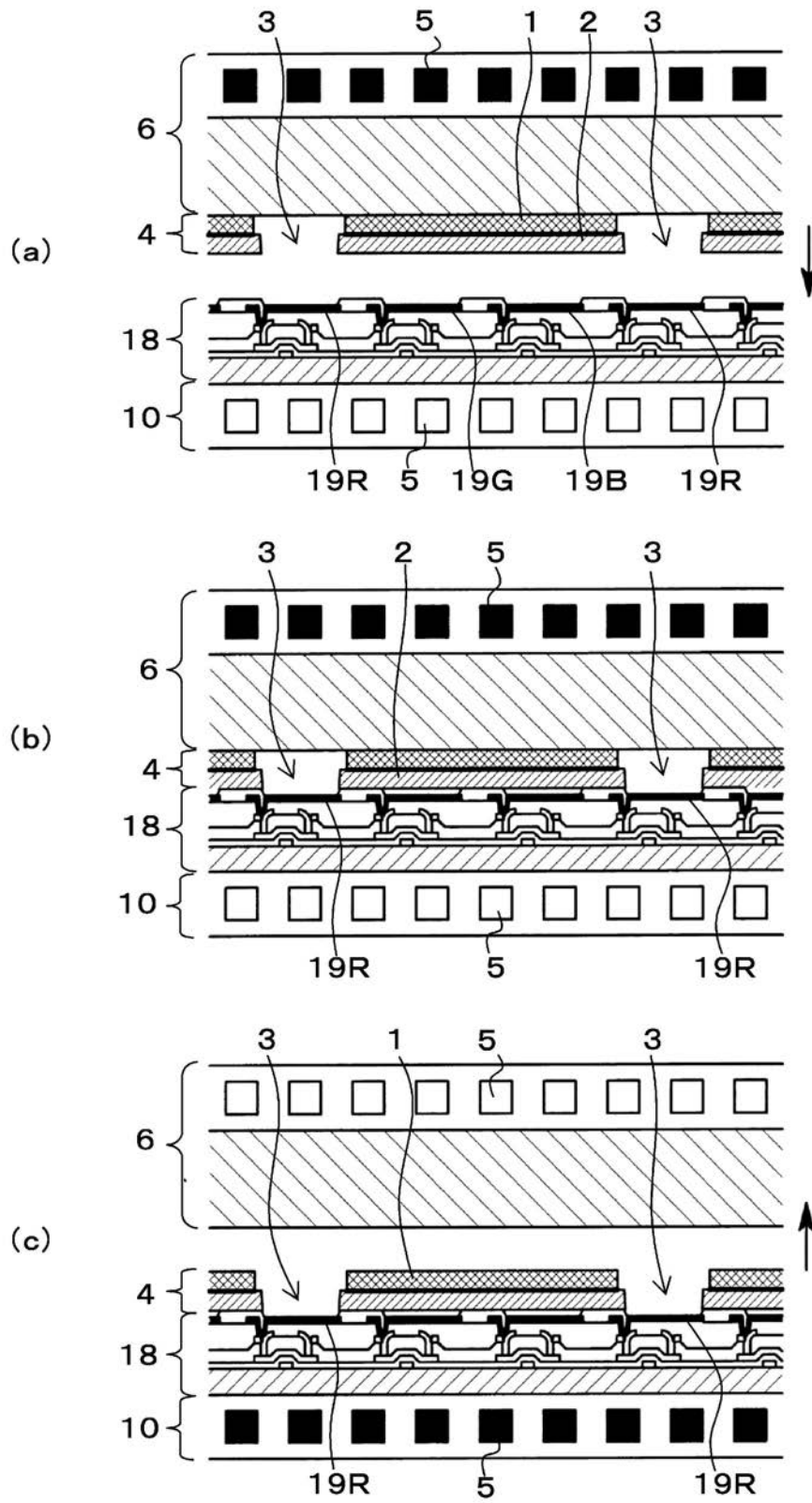
【図 4】



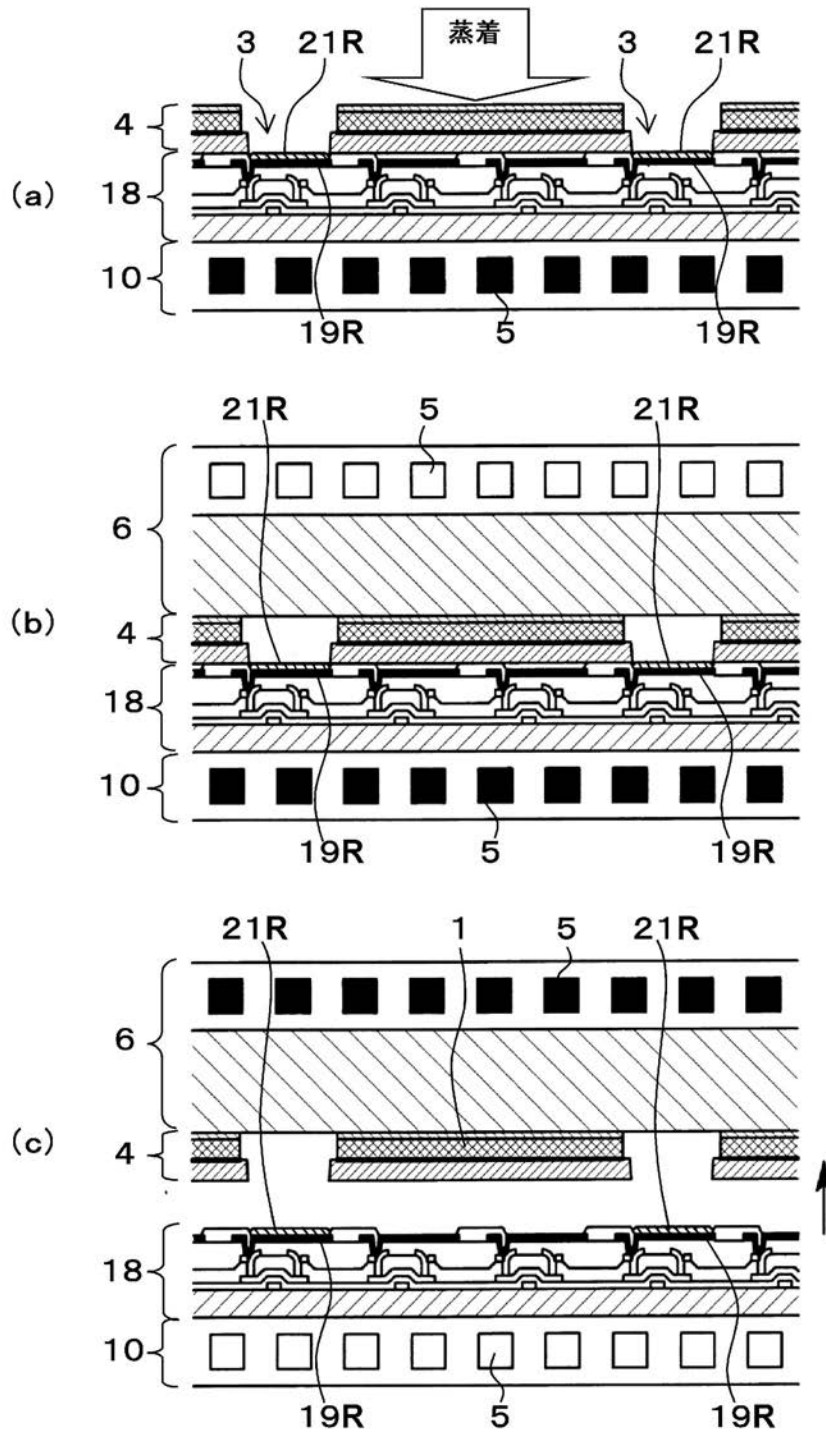
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【 図 8 】

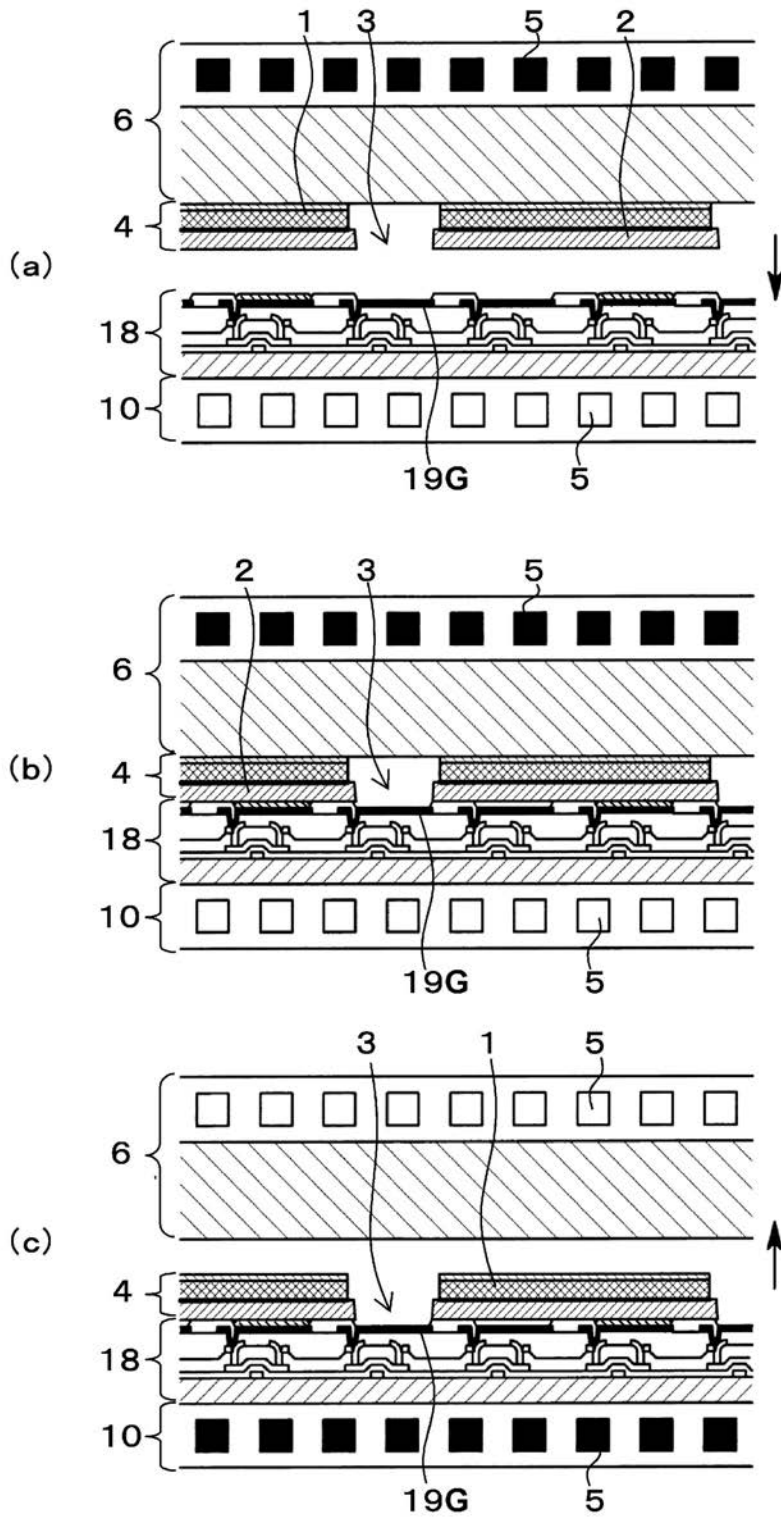
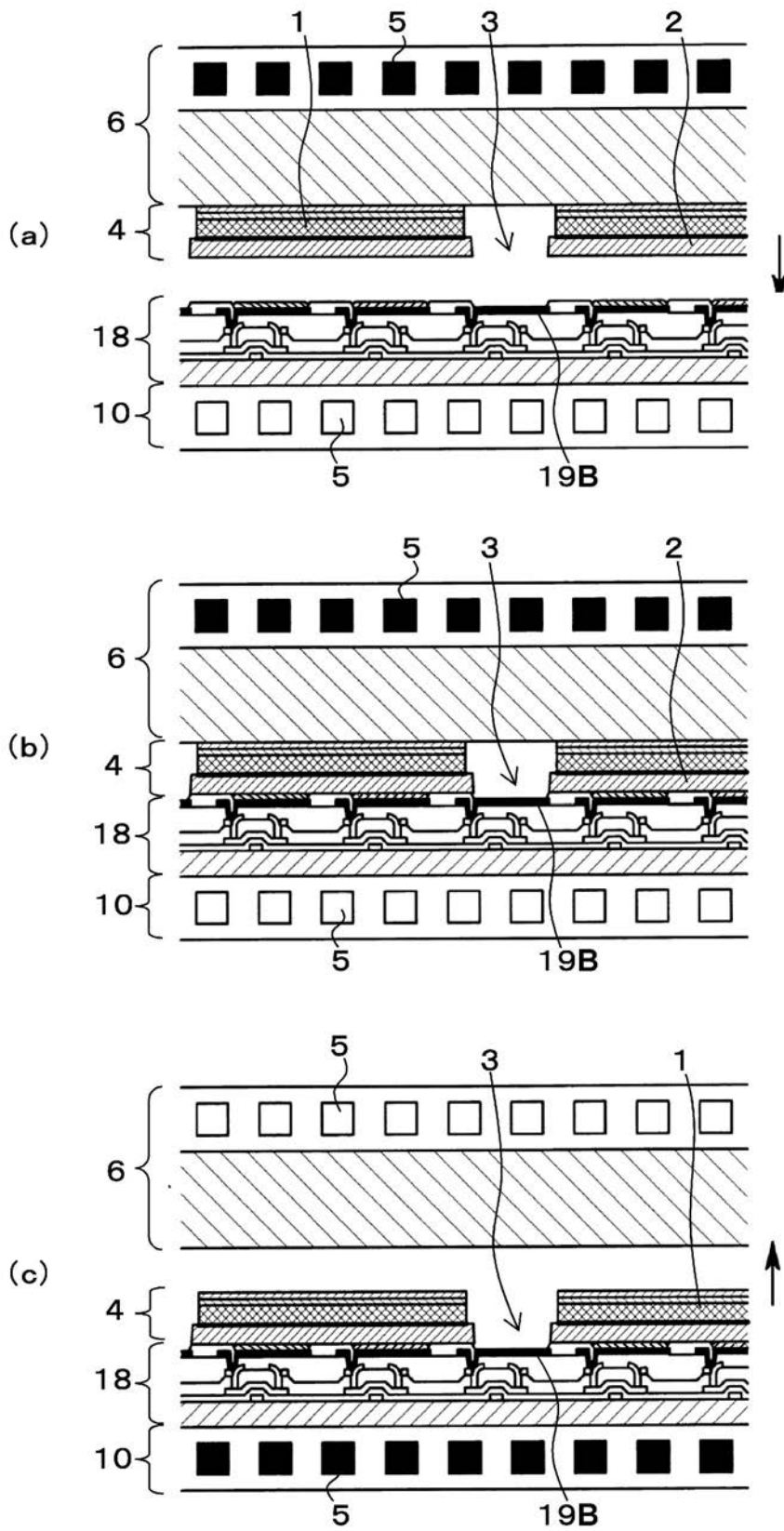


Figure 1 consists of three cross-sectional views of a display device, labeled (a), (b), and (c), showing the sequential deposition of layers.

- (a)** The initial structure shows a substrate with a series of rectangular openings. Above the openings, there are layers labeled 4, 18, and 10. A layer labeled 5 is shown below the openings. A vapor deposition process (蒸着) is indicated by an arrow pointing to the top surface.
- (b)** A layer labeled 21G is deposited on top of the structure shown in (a). The layer 5 is still present below the openings.
- (c)** A layer labeled 1 is deposited on top of the structure shown in (b). The layer 5 is still present below the openings.

【 図 1 0 】



フロントページの続き

(74)代理人 100168608

弁理士 梶 大樹

(72)発明者 水村 通伸

神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 1 3 4 番地 株式会社ブイ・テクノロジー内

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC35 CC45 EE03 GG04 GG28 GG32 GG33

4K029 AA09 AA24 BA62 BB03 CA01 DB06 DB18 HA02 HA03

专利名称(译)	形成薄膜图案的方法，制造有机EL显示装置的方法，有机EL显示装置		
公开(公告)号	JP2013089586A	公开(公告)日	2013-05-13
申请号	JP2011232538	申请日	2011-10-24
[标]申请(专利权)人(译)	V科技股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	有限公司航标科技		
[标]发明人	水村通伸		
发明人	水村 通伸		
IPC分类号	H05B33/10 H01L51/50 C23C14/04		
FI分类号	H05B33/10 H05B33/14.A C23C14/04.A G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC35 3K107/CC45 3K107/EE03 3K107/GG04 3K107/GG28 3K107/GG32 3K107/GG33 4K029/AA09 4K029/AA24 4K029/BA62 4K029/BB03 4K029/CA01 4K029/DB06 4K029/DB18 4K029/HA02 4K029/HA03 5C094/AA05 5C094/AA43 5C094/AA46 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/GB01		
代理人(译)	不二Sasashima 小川 护晃 荒木邦夫		
其他公开文献	JP5953566B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：为了便于薄膜的高清晰度图案化。解决方案：在基板9上具有特定形状的薄膜的图案化方法包括：形成与薄的形状相同的穿透开口图案3的步骤薄膜图案12在薄膜2中透射可见光并且具有响应于薄膜图案化区域11施加到一个表面上的磁体薄膜1，并且对准通过吸附磁体薄膜保持的掩模4的开口图案3在第一磁性卡盘6的平面1的一侧到安装在第二磁性卡盘10上的基板9的薄膜图案区域11;借助于第二磁性卡盘吸引磁性体膜1并将掩模4从第一磁性卡盘6转移到基板9上的步骤;以及通过掩模4的开口图案3在基板9上的薄膜图案化区域11中沉积膜来形成薄膜图案12的步骤。

